

レーザースルーホールフィリング用硫酸銅めっき添加剤

トツプルチナLTF

Additives for Acid Copper Plating to Fill Laser Through-hole Filling

TOP LUCINA LTF

●低膜厚でスルーホールフィリングを実現

●低膜厚化によって配線の微細化に対応

●コア基板形成の工程簡略化が可能

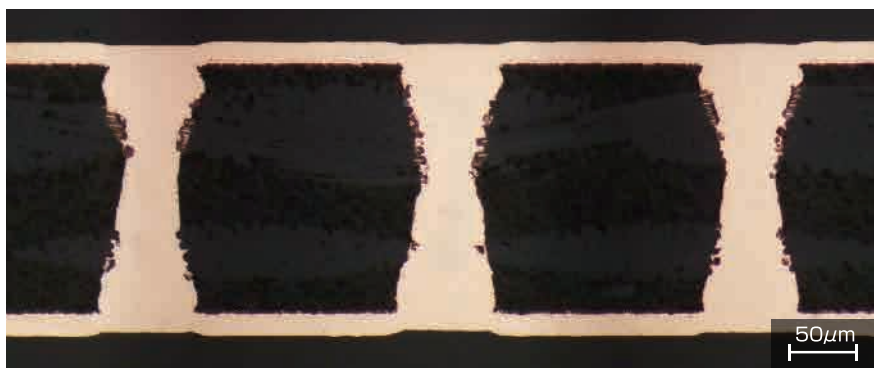
●全ての添加剤成分の定量分析が可能

- Realize through-hole filling by thin thickness
- Applicable to micro-patterning by thin thickness
- Can reduce treatment steps by forming core substrates
- Quantitative analysis is possible for all additives

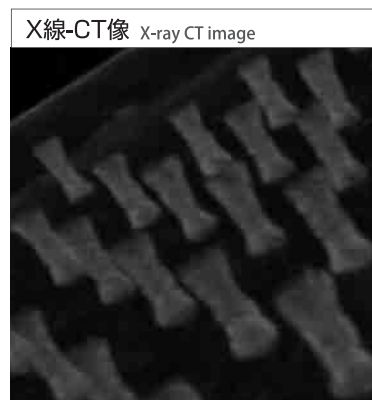
低膜厚でスルーホールフィリングを実現

Realize through-hole filling by thin thickness

硫酸銅五水和物 CuSO ₄ ·5H ₂ O
230g/L
硫酸 H ₂ SO ₄
70g/L
塩化物イオン Cl ⁻
30mg/L
電流密度 Current density
1.0A/dm ²

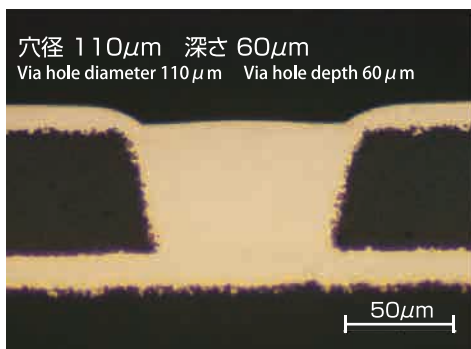


穴径 80μm 板厚 200μm めっき膜厚 15μm
Hole diameter 80 μm Board thickness 200 μm Film thickness 15 μm



ビアフィリングめっきも可能

Also, can be used for via filling



めっき膜厚 10μm
Plating thickness 10 μm

パターンめっきにも対応

Also, applicable to pattern plating

